

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 1 月 13 日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/004216 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/301, 21/52, C09J 7/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009629

(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 7 日 (07.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2003-271950 2003 年 7 月 8 日 (08.07.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リン  
テック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP];  
〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐伯 尚哉  
(SAIKI, Naoya) [JP/JP]; 〒3430806 埼玉県越谷市宮本  
町 1-1 4 8-1-2 0 3 Saitama (JP).

(74) 代理人: 鈴木 俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031  
東京都品川区西五反田七丁目 1 3 番 6 号 五反田山  
崎ビル 6 階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,  
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可  
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,  
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,  
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,  
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,  
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,  
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,  
TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: HARDENABLE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE SHEET FOR DICING/DIE-BONDING AND METHOD FOR  
MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: ダイシング・ダイボンド用粘接着シートおよび半導体装置の製造方法

(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide a hardenable pressure sensitive adhesive sheet for dicing/die-bonding, which is free from  
the generation of voids between a hardenable pressure sensitive adhesive layer and a die pad portion even when a chip is placed on a  
die pad portion having great undulation and thus is excellent in embedment characteristics. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS]  
A hardenable pressure sensitive adhesive sheet for dicing/die-bonding, characterized in that it comprises a substrate and, provided  
thereon, a hardenable pressure sensitive adhesive layer which exhibits a ratio ( $M_{100}/M_{50}$ ) of the modulus of elasticity at 100°C ( $M_{100}$ )  
to the modulus of elasticity at 50°C ( $M_{50}$ ) of 0.5 or less.

(57) 要約: [解決課題] 高低差の大きなダイパッド部にチップを搭載した場合でも、ダイパッド部と粘接着剤  
層との間にボイドが発生することない、埋め込み性に優れた粘接着剤層を有するダイシング・ダイボンド用粘接着  
シートを提供することを目的としている。 [解決手段] 本発明に係るダイシング・ダイボンド用粘接着シート  
は、100°Cでの弾性率 ( $M_{100}$ ) と 70°Cでの弾性率 ( $M_{70}$ ) との比 ( $M_{100}/M_{70}$ ) が 0.5 以下である粘接着剤層  
が基材上に設けられてなることを特徴としている。

WO 2005/004216 A1